

# 平安证券股份有限公司

## 关于上海韦尔半导体股份有限公司

### 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“韦尔股份”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“公开发行可转债”）的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对韦尔股份发行可转换公司债券募集资金 2021 年度存放与使用情况的事项进行了核查，具体核查情况及意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）2021 年公开发行可转债实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（已获得证监许可[2020]3024 号）核准，公司公开发行人民币 24.40 亿元可转换公司债券，期限 6 年。本次公开发行可转债募集资金总额为人民币 24.40 亿元，扣除承销及保荐费用、律师费用、审计验资费用、资信评级费及信息披露费用等其他发行费用合计人民币 52,839,000.00 元（含税），实际募集资金为人民币 2,387,161,000.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 1 月 5 日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA10003 号）。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用公开发行可转债募集资金投入募项目 532,532,253.00 元（其中置换以自筹资金预先投入募集资金为 120,888,627.29 元），募集资金专户余额为 1,860,436,738.24 元。

## (二) 2021 年公开发行可转债募集资金使用情况及结余情况

单位：元

| 募集资金账户情况               | 公开发行可转债募集资金             |
|------------------------|-------------------------|
| <b>1、募集资金账户期初余额：</b>   | <b>0.00</b>             |
| <b>2、募集资金账户资金的增加项：</b> |                         |
| 募集资金流入                 | 2,393,080,000.00        |
| 利息收入                   | 5,821,195.28            |
| 归还暂时补充的流动资金            |                         |
| 自有资金划入募集资金账户           |                         |
| <b>3、募集资金账户资金的减少项：</b> |                         |
| 置换以自筹资金预先投入            | 120,888,627.29          |
| 募集资金投入募集项目             | 411,643,625.71          |
| 支付发行费用                 | 5,919,000.00            |
| 自筹资金投入募集项目             |                         |
| 支付银行手续费                | 13,204.04               |
| <b>4、募集资金账户期末余额：</b>   | <b>1,860,436,738.24</b> |

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 2021 年公开发行可转债募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规，并结合实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的要求并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储。

公司与中国民生银行股份有限公司上海分行、平安证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与招商银行股份有限公司上海分行、平安证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及公司子公司豪威半导体（上海）有限责任公司、兴业银行股份有限公司上海嘉定支行、平安证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及公司子公司豪威科技（上海）有限公司、公司子公司 OmniVision Technologies, Inc.、平安银行股份有限公司

上海分行、平安证券签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。

公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》、《募集资金专户存储五方监管协议》与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## （二）募集资金专项账户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年公开发行可转债募集资金在各监管银行账户的存储情况如下：

单位：元

| 序号 | 账户名称                          | 专户银行名称           | 账号                 | 余额                      |
|----|-------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------|
| 1  | 上海韦尔半导体股份有限公司                 | 招商银行股份有限公司上海张江支行 | 121908236710307    | 814,988.04              |
| 2  | 上海韦尔半导体股份有限公司                 | 中国民生银行股份有限公司上海分行 | 632634897          | 41,607.53               |
| 3  | 上海韦尔半导体股份有限公司                 | 平安银行股份有限公司上海分行   | 15006188888809     | 393,950.88              |
| 4  | 豪威半导体（上海）有限责任公司               | 兴业银行股份有限公司上海嘉定支行 | 216130100100280966 | 6,599,376.79            |
| 5  | 豪威半导体（上海）有限责任公司               | 兴业银行股份有限公司上海嘉定支行 | 216130100100307182 | 835,554,108.49          |
| 6  | 豪威半导体（上海）有限责任公司               | 兴业银行股份有限公司上海嘉定支行 | 216130100100307203 | 179,759,128.30          |
| 7  | 豪威半导体（上海）有限责任公司               | 兴业银行股份有限公司上海嘉定支行 | 216130100100307312 | 57,148,166.10           |
| 8  | 豪威科技（上海）有限公司                  | 平安银行股份有限公司上海分行   | 15119618888860     | 0.00                    |
| 9  | OmniVision Technologies, Inc. | 平安银行股份有限公司上海分行   | FTN15555788816865  | 780,125,412.11          |
| 合计 |                               |                  |                    | <b>1,860,436,738.24</b> |

## 三、2021 年公开发行可转债募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

2021 年，公司实际使用公开发行可转债募集资金具体情况详见附表 1《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

## （二）募投项目先期投入及置换情况

2021年5月17日，公司召开第五届董事会第三十六次会议审议和第五届监事会第三十三届会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用2021年公开发行可转债募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为人民币120,888,627.29元。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了明确同意的意见。

2021年5月17日，立信出具了《关于上海韦尔半导体股份有限公司以可转债募集资金预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZA13801号），公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为120,888,627.29元。

2021年5月17日，平安证券出具了《关于上海韦尔半导体股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，对于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金无异议。

## （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

## （四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2021年，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况、不存在投资相关产品情况。

## （五）节余募集资金使用情况

2021年，公司不存在节余募集资金使用情况。

## （六）超募资金使用情况

2021年，公司不存在超募资金使用情况。

## （七）尚未使用的募集资金用途和去向

截至2021年12月31日，尚未使用募集资金余额人民币1,860,436,738.24

元，未来将陆续投资于晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）、CMOS 图像传感器研发升级、晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目、高性能图像传感器芯片测试扩产项目、硅基液晶投影显示芯片封测扩产项目。

#### **四、变更 2021 年公开发行可转债募投项目的资金使用情况**

##### **（一）增加实施主体**

2021 年 1 月 18 日，公司召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十九次会议，审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》。公司决定将募投项目之一“CMOS 图像传感器研发升级”实施主体由子公司豪威科技（上海）有限公司变更为子公司豪威科技（上海）有限公司和 OmniVision Technologies, Inc.共同实施。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

##### **（二）变更募集资金投向**

2021 年 7 月 13 日，公司召开第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第三十六次会议；2021 年 8 月 2 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会以及 2021 年第一次可转换公司债券债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》。同意公司减少原募集资金投资项目之一“晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）”的投资金额，并将调整的募集资金用于新增的晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目、高性能图像传感器芯片测试扩产项目和硅基液晶投影显示芯片封测扩产项目。可转换公司债券募投项目其他内容均保持不变。

本次募集资金项目变更有利于公司提高募集资金使用效率，抓住 CMOS 图像传感器行业的发展机遇，提升公司在相关领域的产品研发和生产能力，更好的满足下游多样化的市场需求。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。平安证券出具了《关于上海韦尔半导体股份有限公司可转换公司债券募集资金投资项目变更的核查意见》，对公司可转换公司债券募集资金投资项目变更的事项无异议。

## **五、2021年公开发行可转债募集资金使用及披露中存在的问题**

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

## **六、会计师对2021年度募集资金年度存放和使用情况的鉴证意见**

立信对公司2021年度募集资金存放与使用情况进行了专项审核，并出具了《关于上海韦尔半导体股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZA11025号），认为：韦尔股份2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了韦尔股份2021年度募集资金存放与使用情况。

## **七、保荐机构的主要核查工作**

2021年，保荐机构的保荐代表人通过查阅韦尔股份募集资金专项存储账户银行对账单、募集资金大额使用原始凭证、韦尔股份关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件、年度募集资金存放与使用专项报告、会计师出具的募集资金年度使用情况鉴证报告等资料、现场检查、与韦尔股份管理层及相关人员就募集资金使用情况进行沟通交流、列席相关会议等多种方式，对韦尔股份募集资金的管理、存放、使用及信息披露情况等方面进行了核查。

## **八、保荐机构的核查意见**

经核查，保荐机构认为：2021年度，韦尔股份严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了募集资金监管协议，募集资金具体使用情况符合《上海

证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不存在违规使用募集资金的情况。

（以下无正文）

附表 1:

可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

| 募集资金总额             |                 |            |            | 238,716.10    |                                                                                                                         | 本年度投入募集资金总额   |                                 |                            |               |          | 53,253.22 |               |
|--------------------|-----------------|------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|----------------------------|---------------|----------|-----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额        |                 |            |            | 111,558.46    |                                                                                                                         | 已累计投入募集资金总额   |                                 |                            |               |          | 53,253.22 |               |
| 变更用途的募集资金总额比例      |                 |            |            | 46.73%        |                                                                                                                         |               |                                 |                            |               |          |           |               |
| 承诺投资项目             | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额    | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额                                                                                                                 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)<br>(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益  | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 晶圆测试及晶圆重构生产线项目(二期) | 有               | 130,000.00 | 18,441.54  | 18,441.54     | 17,847.08                                                                                                               | 17,847.08     | -594.46                         | 96.78                      | 2022年5月       | 不适用      | 不适用       | 否             |
| CMOS 图像传感器研发升级     | 无               | 80,000.00  | 80,000.00  | 80,000.00     | 2,130.37                                                                                                                | 2,130.37      | -77,869.63                      | 2.66                       | 2024年3月       | 不适用      | 不适用       | 否             |
| 补充流动资金             | 无               | 28,716.10  | 28,716.10  | 28,716.10     | 28,716.10                                                                                                               | 28,716.10     | 0.00                            | 100.00                     | 不适用           | 不适用      | 不适用       | 否             |
| 晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目    | 有               | 0.00       | 83,482.95  | 83,482.95     | 8.94                                                                                                                    | 8.94          | -83,474.01                      | 0.01                       | 2023年7月       | 不适用      | 不适用       | 否             |
| 高性能图像传感器芯片测试扩产项目   | 有               | 0.00       | 20,899.15  | 20,899.15     | 2,942.59                                                                                                                | 2,942.59      | -17,956.56                      | 14.08                      | 2023年1月       | 不适用      | 不适用       | 否             |
| 硅基液晶投影显示芯片封测扩产项目   | 有               | 0.00       | 7,316.53   | 7,316.53      | 1,608.14                                                                                                                | 1,608.14      | -5,708.39                       | 21.98                      | 2023年8月       | 不适用      | 不适用       | 否             |
| 合计                 |                 | 238,716.10 | 238,856.27 | 238,856.27    | 53,253.22                                                                                                               | 53,253.22     | -185,603.05                     | 22.30                      | /             | /        | /         | /             |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) |                 |            |            |               | 无                                                                                                                       |               |                                 |                            |               |          |           |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明   |                 |            |            |               | 无                                                                                                                       |               |                                 |                            |               |          |           |               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况  |                 |            |            |               | 2021年5月17日,公司召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,置换金额为人民币120,888,627.29元。 |               |                                 |                            |               |          |           |               |

|                        |                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      | 无                                                   |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 无                                                   |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无                                                   |
| 募集资金结余的金额及形成原因         | 截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 1,860,436,738.24 元。 |
| 节余募集资金其他使用情况           | 无                                                   |

附表 2:

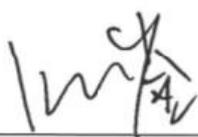
变更募集资金投资项目情况表

单位: 人民币万元

| 变更后的项目                      | 对应的原项目             | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%)<br>(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|-----------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------------|---------------|----------|----------|-------------------|
| 晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目             | 晶圆测试及晶圆重构生产线项目(二期) | 83,482.95      | 83,482.95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.94      | 8.94        | 0.01                   | 2023年7月       | 不适用      | 不适用      | 否                 |
| 高性能图像传感器芯片测试扩展项目            | 晶圆测试及晶圆重构生产线项目(二期) | 20,899.15      | 20,899.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,942.59  | 2,942.59    | 14.08                  | 2023年1月       | 不适用      | 不适用      | 否                 |
| 硅基液晶投影显示芯片封测扩展项目            | 晶圆测试及晶圆重构生产线项目(二期) | 7,316.53       | 7,316.53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,608.14  | 1,608.14    | 21.98                  | 2023年8月       | 不适用      | 不适用      | 否                 |
| 合计                          |                    | 111,698.63     | 111,698.63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,559.67  | 4,559.67    | /                      | /             | /        | /        | /                 |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) |                    |                | 2021年7月13日,公司召开第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第三十六次会议审议通过了《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》。公司决定减少原募集资金投资项目之一“晶圆测试及晶圆重构生产线项目(二期)”的投资金额,并将调整的募集资金用于新增的“晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目”、“高性能图像传感器芯片测试扩产项目”和“硅基液晶投影显示芯片封测扩产项目”。可转换公司债券募投项目其他内容均保持不变。上述事项已经公司于2021年8月2日召开的2021年第一次临时股东大会及2021年第一次债券持有人会议审议通过。相关详情请见公司于2021年7月14日披露的《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的公告》(公告编号:2021-081)。 |           |             |                        |               |          |          |                   |
| 未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)      |                    |                | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |             |                        |               |          |          |                   |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明        |                    |                | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |             |                        |               |          |          |                   |

（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于上海韦尔半导体股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人签名：



姚 崑



董 倩

